

# STS400 ソケット・シリーズ

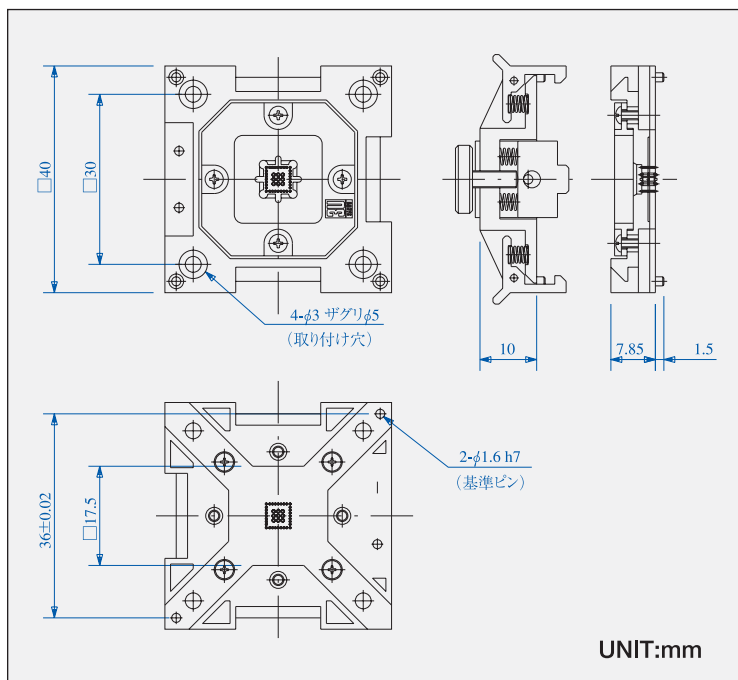
STS400 Socket・Series

## 特長 [Features]

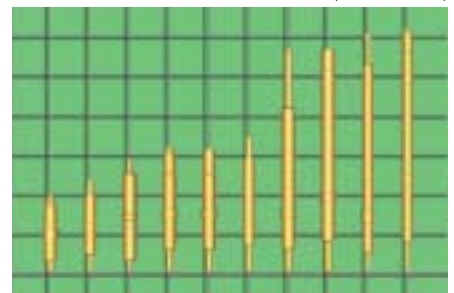
- ◆最大パッケージサイズ□13mm まで対応。  
Maximum package size; Available □13mm max.
- ◆□40mmの標準成形部品に最小限の加工を施し短納期対応が可能。  
Quick delivery with minimum process on standard formed product of □40mm.
- ◆高周波デバイス対応。  
Applied to RF devices.
- ◆0.4mm~0.8mmピッチまで対応可能。  
Pitch available for 0.4mm-0.8mm.
- ◆DUT基板チップ部品実装対応及びソケット実装面積効率アップ。  
Applied to mounting DUT board chip component and enlarged socket mounting area.
- ◆フローティング構造対応。(プローブピン3mm以上仕様のみ対応)  
Applied to floating structure. (For only 3mm and more spec. Probe pin)
- ◆デバイスコンタクトセンサー用ホール対応可能。  
Capacitated to holes for device contact sensor.
- ◆プローブピン ( $\ell=2.0\sim 6.2\text{mm}$ ) とLコンタクトを使い分け、メンテナンスが容易にできます。  
Usable probe pin ( $\ell=2.0\sim 6.2\text{mm MAX}$ ) or L contact with easy maintenance.
- ◆パッケージ固定がクラムシェル、マニュアルワンタッチの選択可能。  
Alternative of fixing packages; "Clam shell" or one-touch operation.
- ◆バーインテスト用 ( $\ell=6.1\text{mm Type}$ ) 対応可能。  
Applicable for Burn- in test. ( $\ell=6.1\text{mm type}$ )



## STS400寸法図 [STS400 Dimension]



1メッシュ: 1mm (1mesh: 1mm)



対応プローブ  $\ell=2.0\sim 6.2\text{mm}$   
Applicable Probe  $\ell=2.0\sim 6.2\text{mm}$

1メッシュ: 1mm (1mesh: 1mm)



対応Lコンタクト  
Applicable L contact

◆プローブ仕様・特性についてはページ14~22をご覧ください。  
(Please refer to Page 14 - 22 for Probe specification and characteristics.)

◆ハウジング材料はページ11をご覧ください。  
Please refer to Page. 11 for Housing Materials.